

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-11

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称 及人员姓名（排 名不分先后）	招商证券
时间	2021年6月24日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君。
投资者关系 活动主要内容 介绍	交流主要内容： Q1、请简要介绍公司6月24日公告中所述的广州封装基板生产基地项目。 公司拟以自有资金及自筹资金60亿元在广州设立封装基板生产基地。项目主要产品为FC-BGA、FC-CSP及RF封装基板，项目整体达产后预计产能约为2亿颗FC-BGA、300万PNL RF/FCCSP等有机封装基板。公司拟在广州成立全资子公司作为广州封装基板项目的实施主体。目前项目整体进展处于拟参与竞拍土地使用权的前期阶段。整个项目建设周期分为两期，公司将在完成子公司设立、土地招拍挂等前期事项后，分阶段开展项目建设。 Q2、请介绍公司对广州封装基板项目的投资规划。 广州封装基板项目总投资金额约60亿元人民币，资金来源为公司自有资金及自筹资

金。公司会根据项目建设的具体执行情况，以滚动式投资的方式分期投入资金。

Q3、请介绍目前封装基板的市场前景。

随着 5G 建设及应用的逐步推进，数据中心、智能驾驶、AI、高性能计算等领域需求热度持续高涨，其所需的主要核心 IC 市场规模迎来高速增长的机会。同时，随着 5G 手机等终端数量逐年增加，手机等智能终端所需的应用处理器、射频模组等 IC 需求也稳步增长。封装基板作为集成电路封装的核心材料之一，具有广阔的市场前景。

Q4、请介绍目前封装基板市场竞争格局。

全球封装基板市场高度集中，行业在技术、资金及人力资本等方面存在较高的门槛，公司作为国内封装基板领域的先行者以及 02 专项基板项目的主承担单位，已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。相较于其他内资封装基板厂商，具有相当的技术和先发优势。

Q5、公司广州封装基板项目涉及产品属于 ABF 材料还是 BT 类材料？

广州封装基板项目主要产品为 FC-BGA、FC-CSP 及 RF 封装基板。其中 FC-BGA 封装基板产品使用 ABF 材料，FC-CSP、RF 封装基板产品使用 BT 类材料。

Q6、请介绍广州封装基板项目涉及的产品原材料及设备的主要来源。

广州封装基板项目所涉及的原材料、设备主要依赖于进口。公司已与主要原材料供应商达成合作意向，将积极保障原材料供应；项目建设所需主要设备主要由现有的成熟供应商提供，公司与供应商合作稳定，将继续与供应商保持良好合作关系，确保设备按期交付。

Q7、请介绍公司深圳、无锡封装基板工厂与广州封装基板项目在产品定位上的区别。

公司目前现有深圳 2 家、无锡 1 家封装基板工厂，其中深圳封装基板工厂主要面向 MEMS 微机电系统封装基板、指纹模组、RF 射频模组等封装基板产品；无锡封装基板工厂主要面向存储类封装基板，且具备 FC-CSP 产品技术能力。广州封装基板项目主要面向

	FC-BGA 封装基板、RF 封装基板及 FC-CSP 封装基板产品。目前公司现有工厂已具备 RF 封装基板与 FC-CSP 封装基板的批量生产能力, FC-BGA 封装基板技术将在现有平台基础上进行深度孵化, 公司目前已投入对 FC-BGA 封装基板产品技术的研发。 Q8、请介绍公司数据中心 PCB 业务目前关于下一代服务器平台 Whitley 的 PCB 产品供需情况。 数据中心是公司看好并重点发展的领域之一。从 PCB 供给端来看, 目前 Whitley 平台产品订单量的比重有所增加。 注: 调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定, 未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2021 年 6 月 28 日